

世界初の軟包装用水なしオフセット機を技術発表

多様化する軟包装業界のニーズに応える提案

㈱ミヤコシ

株式会社ミヤコシ (宮腰亨社長) は3月18日, 19日 の2日間、宮腰精機国見工場(秋田県大仙市)において OPEN HOUSE 2019春を開催, 軟包装向け水なし LED-UV間欠オフセット輪転機 VPP13WL、包装紙 向け水性フレキソ+カットシート装置MFX52S.プラ イマー搭載オフセット輪転機MHL13Aの3機種を発 表した。特に、VPP13WLについては国立研究開発法 人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下 NEDO) のプロジェクトにおいて開発された世界初の 軟包装用水なしオフセット印刷機であるほか. 環境. 省 エネ, 効率化, 小ロット多品種など多様化する軟包装業 界のニーズに応える提案が注目され、多数が来場した。

会期初日の午後の部であいさつに立った宮腰社長は、

国見工場の沿革につ いて「約40年前に設 立され、当社の事業の 中でオフセット印刷機, フレキソ印刷機, 凸版 印刷機、加工機などア ナログの機械を専門 に製造している。業界 内での設備投資はデ ジタルが主流との印



宮腰社長

象もあると思うが、今回見学する機械以外にも出荷前 の機械があり、まだまだアナログの設備投資が進んで いる印象を持っていただけると思う」と紹介。

また、今回の3機種を発表した背景について「ミヤ

コシは. ビジネスフォー ム印刷機メーカーという イメージをお持ちの方も いると思うが、数年前か ら生活産業資材向け機械 の開発にも積極的に取り 組む方針を打ち出し、ラ ベル向け、パッケージ向 けの開発を進め、ここへ 来て納入実績も上げてい る。本日ご覧いただく機 械は、そうした過程の中 で、業界のお客さまや、 業界の先輩といった方々 からいただいた課題や要 望などを当社なりに形に



軟包装向け水なしLED-UV間欠オフ輪VPP13WL



ローラー洗浄でVOCフリーを確認

したものだ」と述べた。

続いて、L&I営業課の藤谷課長が各製品のポイン トを解説した。

まず、参考出品されたVPP13WLは、NEDOプロ ジェクトの元, 東レ (日覺昭廣社長) を中心にミヤコシ などが参画して開発されたもので、軟包装材向け印刷 用としては世界初となる水なしオフセット印刷機。

昨年発表されたVAR機では実現しなかった OPP20u. PET12uなどの薄手のフィルムにも印刷 できる間欠機であり、版胴交換が不要であることに加 え、VOCを含む湿し水を使用せず、省電力LED -UV技術によるインキ乾燥方式と組み合わせることで VOCフリー化を実現した。

同システムでは東レの水なし平版と水溶性UVイン キとの併用で、印刷後の洗浄作業においてもVOCを 発生しない水系洗浄液を利用できる。

また. 省電力性が高いLED-UVを使った インキ乾燥方式を組み合わせることで溶剤乾 燥と廃棄処理が不要となり、グラビア印刷方 式に比べてVOC排出量の98%以上の削減と、 印刷機1台あたり約80%減となる年間96万 kwhの電力消費量の削減が可能となった。

さらに、廃棄処理装置や防爆対応設備が不 要となるほか、平版の使用により版代コスト を安く抑えられ、多品種小ロット化が進む軟 包装印刷市場において優れたパフォーマンス を発揮できる。

VPP13WLについては東レの井上氏からも 説明があり、「LED - UV乾燥方式のため省 電力になっているほか、水溶性インキを開発しVOCを 含まない洗浄液で洗浄が可能など、環境に優しい印刷 方式になっている。インキからも溶剤は出ず、湿し水も なく、洗浄時にもVOCは出ないVOCフリーだ。2019 年度中に実用化させたい」と紹介した。

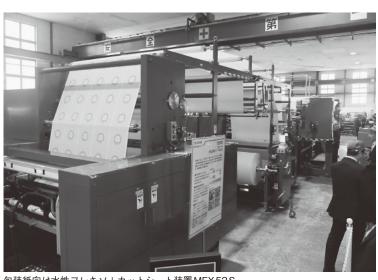
なお、2016年から開始されたプロジェクトには印 刷インキメーカーのT&K TOKA, ユーザーから光 村印刷が参画している。

インライン加工のMFX52S. プライマー処理で対応基材を広げた MHL 13A にも注目

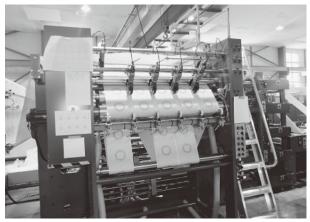
一方, MFX52Sは1,300mm幅の水性フレキソ機 で、紙加工品の中でも大量ロットものをインラインで フィニッシングするシステム。薄手の紙を5列にスリ ットした後、リボン1列に重ね合わせシートカットし 所定枚数で排出する。

工程削減と納期短縮を実現し、少人数オペレーショ ンが可能。また、フレキソ印刷部は、省スペース・低 コストのスタック型方式を採用し、要望に合わせ印刷 部も加工部もカスタマイズ可能となっている。

そして、MHL13Aはプライマーのコーティングユ ニット (フレキソ方式) を搭載し、使用可能な基材の 選択肢を大幅に拡げた。また、窒素パージを搭載し LED-UV乾燥により低臭気化を実現している。



包装紙向け水性フレキソ+カットシート装置MFX52S



5列にスリット出しするリボン部

続いて、工場内での見学となった。

まず、VPP13WLではPETフィルム (12μ) とOPP フィルム (20μ) でのCMYKと白印刷が行われたほか、ローラー洗浄の模様も紹介され、VOC計でVOCの発生がないことも確認された。

また、MFX52Sでは富士フイルムの水現像フレキソ版FLENEX FW-L2を使用し、薄紙のハンバーガー用包装紙を印刷した後、加工部で両端カットと5列スリットを行いシートカットするインライン加工の模様を実演。そして、MHL13AではPETフィルム (12μ) でコーティングユニットにおけるプライマー処理 (DIC製軟包装用水性プライマー「ハイドランAP-301」を使用)から印刷までの流れが紹介された。

今回紹介された3機種の特長、仕様は次の通り。



〈特長〉

- ・シリンダー交換不要
- ・水なしLED-UVオフセットインキ
- ・デジタル制御による準備時間、ヤレ紙削減
- ・天地サイズは数値入力のみで215.9mm~406.4mmまで対応
- ・ミヤコシ独自の圧胴ステップバックにて $12\mu m$ の基 材まで対応
- ・ユニット数は自由自在、白の2度刷り、特色、ニスなどの印刷が可能



リボンを1列に重ねシートカットへ

- ・色間窒素パージでの低臭気化
- ・分速300shotの間欠動作での高速印刷
 - ※窒素パージとは、窒素を充填することによりインキ乾燥の酸素阻害を 減少させる技術。窒素発生装置使用によりランニングコストを抑える。

〈仕様〉

- ·印刷幅 330mm
- · 基 材 幅 350mm
- ·天 地 長 215.9mm~406.4mm
- ·印刷速度 300shot/分(Max120m/分)
- ・使用インキ 水なしLED-UVオフセットインキ
- ・対応基材 OPP. PET. その他基材
- ·紙 厚 12μm~300μm
 - ※仕様は要望によりカスタマイズ対応可能。 ※対応基材は検証の上、対応可能か確認。



包装紙向け水性フレキソ印刷 +インラインシートカット装置 Miyakoshi MFX 52 S

〈特長〉

- ・使用インキはVOC対策不要の水性インキ
- ・フレキソ印刷部は、省スペース・低コストのスタック 型方式 (ワンタワー4色まで印刷ユニット追加可能)
- ・工程削減と納期短縮を実現
- ・インライン加工とデジタル制御により少人数オペレ ーティングが可能
- ・リピート機能によりスタートロスの削減
- ・ユーザーの要望に合わせて印刷部も加工部もカスタ マイズ可能

〈仕様〉

- · 基 材 幅 1.300mm
- ·天 地 長 370mm~800mm
- ・印刷速度 150m/分(加工機の速度に 準じる)
- ・使用インキ 水性フレキソインキ
- ・対応基材 包装紙向け、その他基材
- ・リボン部 スリット,5リボン出し
- ・集 合 部 5列カットマチック制御
- ・シーター部 3~5リボン重ね1列カット
- ・カウントスタッカー部 1列ブロック出し
- ・区分け枚数 最小100枚, 最大2,000枚 ※仕様は要望によりカスタマイズ対応可能。 ※対応基材は検証の上、対応可能か確認。



UV・水性プライマー対応 軟包装用スリーブ式オフセット印刷機 Miyakoshi MHL 13A

〈特長〉

- ・LED-UV乾燥装置の採用により基材への熱影響を 抑えたフィルム印刷が可能
- ・VOC排出がないクリーンで環境に配慮した印刷ソ リューションを実現
- ・ローコストなミヤコシ独自の軽量スリーブを版胴. ブラン胴に採用。基材を切らずに迅速なジョブチェ ンジが可能
- ・プライマーコーティングユニット(フレキソ方式)を 搭載し、インキ適性のない基材に対しても効果を発揮



プライマー部



プライマー搭載軟包装用オフ輪MHL13A

- ・コーティングユニットは水性/UV兼用でコーティ ング剤に応じて対応が可能
- ・窒素パージを搭載してLED UV乾燥により低臭 気化を実現
- ・フレキソ印刷による隠蔽性の高い白印刷も可能(表 印刷時)

〈仕様〉

- · 印刷幅 330mm
- · 基 材 幅 350mm
- ·天 地 長 381.0mm~609.6mm
- ·印刷速度 100m/分
- ・使用インキ LED-UVオフセットインキ
- ・対応基材 OPP, PET, その他基材
- 紙 厚 $15\mu \text{m} \sim 300\mu \text{m}$
- ※仕様は要望によりカスタマイズ対応可能。 ※対応基材は検証の上、対応可能か確認。



幅広い基材に対応